



TE 内部编号 2-2013310-1
SO DIMM Sockets, Double Data Rate (DDR) 3, Stack Height .362 in [9.2 mm], Right Angle Module Orientation, Surface Mount, Cable-to-Board, 204 Position
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 接口插槽 > 内存插槽 > SO DIMM 插槽



DRAM 类型: 双倍数据速率 (DDR) 3
堆叠高度: 9.2 mm [.362 in]
模块方向: 直角
PCB 安装方式: 表面贴装
连接器系统: 缆到板

产品特性

产品类型特性

DRAM 类型	双倍数据速率 (DDR) 3
连接器系统	缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
产品类型	插座

结构特性

托架数	2
中心钥匙	左偏移
钥匙数	1
模块方向	直角
Number of Positions	204
行数	2
键控	标准

电气特征

--	--



DRAM 电压	1.5 V
---------	-------

信号特征

SGRAM 电压	1.5 V
----------	-------

主体特性

弹射器位置	两端
插销材料	不锈钢
插销电镀材料	锡
模块钥匙类型	SGRAM
弹射器类型	锁定
连接器外形	标准

接触件特性

插座种类	SO DIMM
PCB 端子端接区域电镀材料	金
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	镀金
端子额定电流（最大值）	.5 A
插座类型	内存卡

端接特性

插入种类	凸轮
------	----

机械附件

PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	焊钉
PCB 安装方式	表面贴装
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	.6 mm[.024 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	高温热塑性塑料

尺寸

堆叠高度	9.2 mm[.362 in]
Row-to-Row Spacing	8.2 mm[.322 in]

使用环境



工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Emboss on Reel
封装数量	150

其他

注释	带浮动销钉。
----	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



客户还购买了



文档

产品图纸

EMBOSS TAPE DDR3 204P 9.2H STD

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2013310-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2013310-1_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2013310-1_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[6-1773457-3_DDR3_DIMM_SOCKETS](#)

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[MD_2-2013310-1_04152016554_dmtec](#)

英文版本

[MD_2-2013310-1_04152016554_dmtec](#)

英文版本